

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Е.Суворов. SEMICON Russia как зеркало мировой промышленной революции. Новые времена – новая концепция..... №1, с.74

А.Циркунова. Надо просто больше тренироваться..... №5, с.110

П.Кириллов, В.Мейлицев. Аддитивные технологии – что могут сегодня, что смогут завтра? №9, с.142

П.Кириллов. "Микроэлектронная" дискуссия в Крыму: как решить проблемы отрасли?..... №10, с.128

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

И.Шахнович, В.Мейлицев. Productronica 2015: новые решения – российскому рынку. Часть 2..... №2, с.125

И.Шахнович, В.Ежов, В.Мейлицев. Productronica 2015: новые решения – российскому рынку. Часть 3..... №4, с.123

В.Ежов, В.Мейлицев. Productronica 2015: новые решения – российскому рынку. Часть 4 №7, с.152

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

П.Чачин. Юбилейный проект "ЭЛЕКТРОНИКЕ: НТБ" – 20 лет!..... №6, с.32; №7, с.26; №8, с.28; №9, с.34; №10, с.46

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Новые электронные нагрузки EL 9000 В гибкость в конструировании №4, с.98

В.Ежов. Изолированные DC / DC-преобразователи Murata для промышленных приложений №9, с.64

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

А.Фомина. Объединяя лучших, мы опережаем одиночек №1, с.10

Ю.Кириллов. 25-летие НПП "Родник": здоровому бизнесу кризисы не помеха №1, с.18

С.Сорокин. Стремление к лидерству как парадигма развития бизнеса №2, с.10

З.Гросс. Тестирование высокоскоростных оптических сетей – это фундаментально новый набор измерительных принципов №2, с.16

В.Мельников. Интеграция усилий отечественных предприятий как национальная идея №3, с.10

Курс на замещение импорта в радиоэлектронике №3, с.20
 Форум SEMICON Russia для электроники России. Рассказывают ведущие отраслевые эксперты №3, с.26

Р.Нерсесиан. Наша стратегия – быть первыми..... №4, с.10

И.Козлов. Новые рынки – значит, новые компетенции №5, с.10

С.Хохлов. Итоги деятельности радиоэлектронной промышленности в 2015 году. Основные задачи и направления развития на 2016 год №5, с.16

И.Ходаковский. Отечественные модули СВК – примеры эффективного импортозамещения..... №6, с.10

П.Ойхман. Проектная поставка электронных компонентов как эффективная бизнес-модель №6, с.16

А.Богинский. Отрасль начинает меняться – мы готовы к работе по новым правилам..... №7, с.10

Дж.Кимери. Беспроводные сети 5G: от концепции к реальности..... №8, с.10

П.Куцько. Развитие отечественной радиоэлектроники и техническое перевооружение страны возможны только при взаимодействии ведомств №9, с.10

Э. ван дер Хейден. Мы продолжаем считать Россию одним из ключевых рынков №10, с.10

С.Хохлов. Основные ориентиры Стратегии развития радиоэлектронной промышленности №10, с.16

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

А.Разоренов. Multiple Dimensions – год спустя №1, с.167

М.Поляничко. Производственная концепция "Абриса" дает 100%-ный результат №7, с.145

КОМПЬЮТЕРЫ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

А.Медведев. Встраиваемые промышленные компьютеры Fastwel: надежные решения для широкого круга задач №2, с.78

А.Медведев. CompactPCI Serial – универсальный стандарт для построения бортовых компьютеров №6, с.122

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

А.Бардаков. Диагностика тепловых потерь – применение тепловизоров и анализаторов качества электроэнергии..... №1, с.140

М.Мартин. Осциллографы реального времени: методы расширения полосы пропускания №1, с.144

А.Ануфриев. Технологии компании Keysight Technologies на российском предприятии – первый опыт №2, с.86

С.Попов. Rohde & Schwarz – не обязательно дорого №2, с.88

М.Авила. Аттестационные испытания средств беспроводной связи: технологии, которым можно доверять .. №3, с.46

А.Воронин, В.Елин, И.Кудряшов, М.Меркин. Головной усилитель для портативного дозиметра на основе кремниевого детектора "ДО-РА.Модуль" №3, с.54

И.Нотин, А.Чабанов, Т.Адамс. Микросхемы в пластиковом корпусе: три режима акустической микроскопии №3, с.64

Д.Овсов. Исследование характеристик диэлектрических покрытий антенн с помощью векторного анализатора цепей №4, с.102

Т.Тулянцева, Х.Качаев. Аттестация испытательного оборудования: на что обратить внимание?..... №4, с.106

М.Хердин. Осциллограф R & S Scope Rider – портативный прибор с возможностями лабораторного №5, с.80

С.Лютаев. Методы оценки экранирующих свойств кабельных жгутов при испытаниях бортовой аппаратуры на соответствие требованиям по ЭМС..... №5, с.84

Л.Ершов, Р.Левин, А.Батулин, Н.Коломенская, И.Емельянова, В.Кононов. Что такое контрафакт и как с ним бороться. Нормативная основа и практика выявления контрафактных электронных компонентов.....	№6, с.88
С.Ерин. Электромагнитное поле: инструменты визуализации и контроля.....	№7, с.68
П.Руднев, Н.Моисеев, А.Дидык. Спектрометр-дозиметр SDMF-1206PRO.DB – эффективный инструмент для исследования нейтронного и γ -излучения.....	№8, с.78
В.Казарновский, А.Крылов. Методы измерения параметров коаксиально-волноводных переходов и узлов с нестандартным сечением.....	№8, с.82
Дж.Александр. Инвестиции в перспективные технологии сегодня – инновационные продукты завтра.....	№9, с.90
К.Папилов. Измерительные системы для применения в радиолокации – комплексный подход.....	№9, с.94
А.Телегин. Анализатор Keysight CX3300 – эффективный инструмент для анализа сверхмалых токов.....	№9, с.98
А.Подолько, О.Каминский. В России впервые может появиться эталон фазового шума.....	№10, с.84
Н.Лемешко, В.Петров, О.Поветкин, Д.Богаченков. Комплексные решения для испытаний на электромагнитную совместимость на основе программного обеспечения R&S EMC32.....	№10, с.88
Новинки компании Keysight Technologies	№9, с.152; №8, с.88
КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
К.Бунатян. Управление технологическими процессами с использованием трехмерного оптического контроля.....	№3, с.162
В.Кусков, Е.Слепухов, Р.Горемычкин. Динамический рефлектометр для контроля волнового сопротивления микрополосковых линий и дифференциальных пар. Модель ИРС-35.....	№5, с.148
МАТЕРИАЛЫ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
С.Гладких, А.Шестаков, Т.Древаль, Д.Патин, А.Савкин. Токопроводящие клеи для монтажа электроники космического назначения.....	№3, с.156
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА	
А.Бекмачев, С.Садовский, О.Сунцова. Российский прорыв: чехол-кардиограф для смартфона CardioQVARK.....	№7, с.122
МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ	
А.Анучин, А.Жарков, В.Козаченко, М.Лашкевич, И.Потапов. Отечественный микроконтроллер K1921BK01T для управления электродвигателями.....	№9, с.80
А.Гусаров. Семейства микроконтроллеров Atmel на основе платформы Cortex-M.....	№9, с.96
А.Эйланд. Оптимизация энергопотребления микроконтроллеров – решения компании Atmel.....	№9, с.100

Н.Елисеев, И.Шахнович. Arduino – это очень серьезно. Большие возможности маленьких устройств.....	№3, с.88
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Б.Жалнин, М.Каган, А.Наумов. Отечественная космическая энергетика: вчера, сегодня и завтра.....	№2, с.92
А.Алексеев. Модернизация вакуумного технологического оборудования ЗАО "НТО" для разработки и производства ЭКБ.....	№2, с.104
А.Алексеев, С.Петров. Создание мощных СВЧ-транзисторов и микросхем на основе GaN. Отечественный комплекс технологического оборудования....	№5, с.48
А.Скупов. Вакуумное корпусирование на уровне пластины-геттеры.....	№5, с.54
А.Скупов. Обеспечение вакуума при корпусировании на уровне пластины – сварка стеклокерамическим припоем.....	№6, с.94
Н.Василенков, А.Максимов. Металлокерамические корпуса АО "ТЕСТПРИБОР": эффективная защита от ионизирующего излучения.....	№6, с.104
А.Алексеев, О.Агеев, Е.Гусев, Б.Коноплев, И.Лысенко, С.Петров. Тандем ЗАО "НТО" и НОЦ "Нанотехнологии" ЮФУ – пример успешного взаимодействия производства и науки.....	№7, с.78
Л.Пазинич, Л.Сейдман. Технология монтажа мощного транзистора. О тепловом сопротивлении на границах припоя.....	№9, с.72
ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
Г.Мартынов. Программное обеспечение MYCRONIC – платформа, открытая для пользовательских приложений.....	№9, с.192
В.Мейлицев. Станция АЛЬФА-100 – мировой уровень от отечественного производителя.....	№4, с.154
Д.Власов. Рамки для натяжения трафарета производства "ДИАЛ-РЭМ".....	№4, с.158
В.Мейлицев, А.Калмыков, Н.Васюнькин. Платформа Fuzion: централизованное управление сборочно-монтажным производством как инструмент повышения его эффективности.....	№8, с.150
К.Голобоков. Автоматизация хранения комплектующих на производстве.....	№8, с.158
ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
К.Тихомиров, С.Алексеев. Прогнозирование надежности паяных соединений. Термомеханическая усталость: критерий отказа, классификация моделей.....	№10, с.136
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
И.Петухов, В.Ланин. Технология и оборудование для проволочного микромонтажа многокристальных модулей.....	№9, с.178
С.Алексеев. Как совместить бессвинцовые компоненты с оловянно-свинцовыми припоями?.....	№3, с.139

К.Тихомиров, С.Алексеев. Прогнозирование надежности паяных соединений: факторы, приводящие к повреждениям ...	№6, с.172
А.Зайцев. Необходимые перемены	№7, с.182
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА	
А.Никифоров. Электронный автоматический выключатель ESS20: эффективная защита промышленных систем	№6, с.130
РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА	
Н.Корнев. Российские системы микросотовой связи – взгляд изнутри.....	№9, с.56
РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	
В.Мейлицев. Технологическая база для электроники следующих поколений. Визит в цех производства печатных плат АО "Концерн "Автоматика".....	№6, с.155
РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ	
Д.Каброл. Freescale и NXP объединились, продуктовые линейки сохраняются.....	№4, с.38
СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИКА	
М.Червинский. Мощные светодиоды компании Cree: особенности технологии.....	№8, с.60
СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА	
И.Виколов. Гетерогенная интеграция – новый этап развития интегральной СВЧ-электроники.....	№1, с.104
Н.Егоров. Фильтры, кабели и другие ВЧ- и СВЧ-компоненты – продукция компании AWT Global	№1, с.114
В.Тимошенко. Внедрение SiGe-технологии: успехи и перспективы.....	№5, с.60
Е.Балашов, А.Коротков, И.Румянцев. Интегральные КМОП-схемы диапазона СВЧ: опыт разработки.....	№7, с.104
В.Кочемасов. Электромеханические переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов – основные типы и производители. Часть 1.....	№7, с.114
В.Кочемасов. Электромеханические переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов – основные типы и производители. Часть 2.....	№8, с.96
К.Джуринский, А.Андросов. Зарубежные соединители в диапазоне частот до 6 ГГц, не имеющие отечественных аналогов. Часть 1. Соединители SMB и SSMB	№9, с.118
В.Кочемасов. Электромеханические переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов – основные типы и производители. Часть 3.....	№9, с.128
К.Джуринский, А.Андросов. Зарубежные соединители в диапазоне частот до 6 ГГц, не имеющие отечественных аналогов. Часть 2. Соединители MCX и MMCX.....	№10, с.104
Н.Егоров. Высококачественные ВЧ/СВЧ-устройства для различных приложений – продукция компании SignalCore	№10, с.116
СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	
А.Григорьева. Тенденции развития RFID технологий: обзор мирового и российского рынка.....	№4, с.44

Т.Сайзер. Ждать 5G осталось два года	№4, с.50
С.Маргарян. Узкополосная технологическая радиосеть обмена данными УКВ-диапазона на базе платформы Viper-5G.....	№4, с.56
И.Кокорева, И.Шахнович. Цифровое телерадиовещание в России: новый этап развития.....	№5, с.100
М.Пирпоинт, Г.Ребейз. Переход к телекоммуникационным системам 5G – создание каналов связи с фазированными антенными решетками.....	№6, с.114
Э.Старклофф. Беспроводные технологии для IoT – стимулы и тенденции развития	№6, с.118
Н.Варава, С.Пронин, М.Никоноров. ВОЛС в ЛВС и системах сбора информации: выбор физической среды и активной компонентной базы	№8, с.108
СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
Т.Хан. AWR Design Environment: от концепции системы до электромагнитного 3D-анализа	№1, с.130
В.Ежов. САПР от Cadence: системный подход к проектированию печатных плат по материалам семинара компании PCB SOFT	№1, с.134
И.Попов. Специализированный процессор – своими руками проектирование проблемно-ориентированных процессоров в многоядерных системах с помощью ASIP Designer	№3, с.100
А.Милн, Д.Робертс. Минимизация фазовых сдвигов сигналов при трассировке цифровых систем на кристалле	№5, с.92
П.Караваев. Концепция сквозного проектирования на практике: от идеи до готового устройства	№6, с.110
Е.Иванова, Д.Радченко. Сокращение времени разработки проекта за счет анализа RTL-кода на ранних стадиях с помощью DC Explorer.....	№7, с.84
В.Ежов. 3D-моделирование СВЧ-полей с помощью Empire XPU по материалам семинара компании "PCB SOFT"	№7, с.92
А.Курушин, И.Мюккеря, С.Подковырин. Моделирование больших объектов в программной среде FEMO	№7, с.98
Е.Чириков. Altium Draftsman: оформить чертеж – это просто	№8, с.90
Д.Мердок, М.Вудс, Г.Кон. GaN-системы высокой производительности – особенности тепловое анализа	№9, с.102
Е.Чириков. Новые возможности проектирования печатных плат, или зачем пользователям IP-CAD переходить на Altium Designer?	№9, с.108
В.Ежов. Расширенные возможности моделирования аналоговых и цифровых схем в OrCAD PSpice. По материалам семинара компании PCB SOFT.....	№10, с.94

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

В.Ежов. Как повысить эффективность разработки: новые возможности САПР от Cadence..... №5, с.129

СОБЫТИЕ НОМЕРА

И.Шахнович, В.Мейлицев. Productronica 2015: новые решения – российскому рынку. Часть 1..... №1, с.22

И.Шахнович. Российская электроника: новые вызовы. Круглый стол в честь 20-летия журнала "ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ".... №4, с.16

К.Чачин, И.Шахнович. Расширенное совещание руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности России: время перемен №5, с.26

П.Кириллов. Возрождая традиции отечественной микроэлектронной школы по итогам международной конференции "Микроэлектроника-2016"..... №9, с.44

Заседание секции № 9 по участию малого и среднего бизнеса в разработке и производстве электронной компонентной базы межведомственной рабочей группы при коллегии ВПК РФ..... №9, с.52

И.Кокорева. Российская радиоэлектроника: взгляд в будущее..... №10, с.24

Совместное заседание Секции по участию малого и среднего бизнеса в разработке и производстве ЭКБ и агентства стратегических инициатив..... №10, с.30

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В.Беляев. Неделя дисплеев 2016: технологии настоящего и будущего. Часть 1. Выставка и научная конференция №8, с.42

В.Толстопятов. TFT-ЖК-модули компании Mitsubishi Electric для промышленного применения..... №8, с.54

В.Беляев. Неделя дисплеев 2016: технологии настоящего и будущего. Часть 2. Инновационная зона (i-Zone)..... №9, с.136

ТЕМА ГОДА: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Г.Азов, Э.Ганеев, С.Хриткин. Спиральная ЛБВ сантиметрового диапазона: методы проектирования и результаты разработки..... №1, с.155

М.Черных. Выбор конструктивно-технологических параметров мощных СВЧ MESFET-транзисторов на основе карбида кремния..... №1, с.160

В.В.Алексеев, В.А.Телец, В.И.Эннс, В.В.Эннс. Импортзамещение ЭКБ: базовые матричные кристаллы №2, с.107

М.Клименко. Подавление узкополосных помех в сигналах ГНСС с помощью КИХ-фильтров №2, с.112

В.Ануфриев. Малогабаритные модули питания и системы электропитания на их основе №2, с.120

С.Аваков, Е.Дрогун, С.Карпович, Д.Титко, В.Шоломицкий, В.Овчинников. Оптико-механическое оборудование для бездефектного изготовления фотошаблонов..... №3, с.127

А.Алексеев, С.Иванов, С.Сорокин. Тандем отечественной науки и производства для решения перспективных задач оптоэлектроники..... №3, с.134

И.Шахнович. Малый и средний бизнес в создании ЭКБ от взаимодействия с крупными предприятиями до механизмов формирования себестоимости продукции №4, с.111

И.Лукин. Импортзамещение в телекоммуникациях: что считать российским оборудованием?..... №4, с.118

С.Попов. Разработано в России, изготовлено в России №5, с.113

Л.Барышников, С.Баранов, М.Какоулин. Цифровая обработка радиосигнала – решения на основе СБИС АО "ПКК Миландр"..... №5, с.118

А.Комаров. Алгоритм взаимодействия разработчиков и производителей РЭА и ЭКБ..... №5, с.122

В.Шиллер, В.Шпак. Независимость российской электроники от импорта необходима и возможна..... №6, с.145

К.Колегов. Перспективы создания кластеров электроники на Дальнем Востоке..... №6, с.150

В.Эннс, Ю.Кобзев, И.Корепанов. Программируемая аналоговая микросхема КомПАС-1 (5400TP035) – основные характеристики и особенности применения..... №7, с.135

А.Брыкин. Механизмы взаимодействия поставщиков радиоэлектронного комплекса..... №7, с.140

Н.Нагаев. Продукция предприятия "ЗПП": достижения и перспективы..... №8, с.125

Ю.Мякочин, Д.Шедяков, К.Кареев. УСПД на базе Cortex-A9 – вклад в построение надежных систем для ЖКХ .. №8, с.130

А.Акимов, В.Зуев. Пензенский НИИ электронно-механических приборов. Программы развития и импортзамещения..... №8, с.134

А.Наумов. Метод создания мира. К 100-летию открытия метода Чохральского и 60-летию получения первого кристалла германия в России..... №9, с.157

Д.Даниленко, Л.Воронцов. Кросс-платы нового поколения для бортовых вычислительных комплексов №10, с.143

ТЕХНОЛОГИИ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Д.Поцелуев. Трубчатые припои – современный взгляд на технологию ручной пайки..... №1, с.186

О.Симонов. Технология роликовой герметизации: основные параметры, влияющие на качество №2, с.160

О.Симонов. Технология плазменной очистки при микросборке..... №3, с.148

Р.Елфимов. PICO Pulse – новый импульс в технологии струйного дозирования..... №5, с.136

О.Симонов. Современные технологии производства и тенденции в разработке металлокерамических корпусов .. №5, с.140

В.Ефанов. Селективная пайка Fine pitch компонентов, монтируемых в отверстия..... №6, с.182

М.Харт, А.Гаранин. Применение SGA как средство увеличения надежности №7, с.180

О.Симонов. Применение атомно-слоевого осаждения тонких пленок в качестве метода сдерживания роста вискерсов №8, с.162

С.Ванцов, А.Медведев, З.Маунг Маунг, О.Хомутская. Надежность процесса сверления печатных плат, понятие отказа №8, с.168

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

А.Шкодин. Обслуживание оборудования – как оптимизировать затраты №8, с.116

А.Завалко, Н.Кравцов. Управление производственными процессами – переход к интеллектуализированным системам №10, с.122

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

В.Лысов. Стресс-тест для ответственной электроники №8, с.143

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

М.Макушин, В.Мартынов. Новые аспекты развития современной микроэлектроники №3, с.110

А.Барсуков, С.Мурашова, О.Рукина. Изобретательская деятельность – особенности мотивации №3, с.124

Л.Бочаров, В.Корчак, Е.Тужиков. Инициатива военного ведомства США в области оборонных инноваций №6, с.136

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

М.Самойлова. Разъемы ODU с PUSH-PULL защелкой – качество, проверенное временем №1, с.122

А.Коротков, Д.Морозов, М.Пилипко, И.Пятак, Д.Буданов. Аналого-цифровые преобразователи для беспроводных систем связи: опыт разработки №2, с.40

И.Романова. АЦП и ЦАП компании Texas Instruments: новые продукты на рынке №2, с.48

И.Иванов. Методика оценки и сравнения кремниевых фотоумножителей №2, с.62

Б.Александров. Инерциальные датчики: терминология, характеристики, критерии выбора №3, с.68

Д.Балман, Ю.Пономарев. МЭМС-акселерометры компании Colibrys – прорыв в область высоких температур №3, с.72

Н.Ермошин, А.Власов. Отладка авиационных интерфейсов – комплексный подход №3, с.78

В.Геворкян, В.Кочемасов. Объемные диэлектрические резонаторы – основные типы, характеристики, производители. Часть 1 №4, с.62

К.Джуринский, А.Сотников. Продукция тайваньских компаний на российском рынке обзор соединителей миллиметрового диапазона №4, с.78

М.Самойлова. Разъемы ODU для передачи данных: на всех скоростях – fast Ethernet, USB 2.0 №4, с.94

И.Шахнович. Компания Infineon Technologies от сенсоров до решений для опорных сетей в E- и V-диапазонах №5, с.70

В.Геворкян, В.Кочемасов. Объемные диэлектрические резонаторы: основные типы, характеристики, производители. Часть 2 №5, с.76

А.Попков. Пленочные конденсаторы компании Wima на российском рынке №6, с.44

М.Самойлова. Разъемы ODU для техники специального назначения №6, с.52

А.Гасымов. Витебский завод радиодеталей "Монолит" – передовые технологии и качество №6, с.60

В.Ежов. Кольца и браслеты... Новинки компании NXP на MWC-2016 №6, с.70

В.Кочемасов, Е.Хасьянова. Кварцевые автогенераторы: разновидности, характеристики и области применения №6, с.82

Л.Чемакин. Миниатюрные соединительные системы Molex на основе спецификации USCAR 050 для автомобильной промышленности №7, с.42

В.Ершов. Высоконадежные соединители Positronic для различных применений №7, с.50

А.Корнилин. Перспективы развития АО "Завод Электрон" №7, с.62

А.Голощاپов. Твердотельные реле celduc® relais как гарантия высокой надежности №8, с.72

А.Голощاپов. Магнитные бесконтактные датчики, герконовые реле и переключатели: обзор продукции celduc® relais №9, с.82

М.Коган. Наша цель – предлагать только лучшее №10, с.58

Н.Егоров, В.Кочемасов. Технология цифровой радиочастотной памяти и ее применение в системах РЭБ №10, с.62

Т.Аренц. Память LPDDR4 компании Samsung – эффективные решения для различных приложений №10, с.72

М.Макушин, В.Мартынов, Ю.Сухорослова. Парадигма парадигм, или Интернет вещей №10, с.72

ООО СМП



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.SMD.ru

электронные компоненты
для поверхностного монтажа

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ ПОСТАВОК

- микро потребляющий ТСХО 32.768КГц
- чип варисторы для защиты 12В и 24В цепей



Москва, Ленинградский пр., 80 к. 32; e-mail: sale@smd.ru
Тел.: (499) 158-7396, (495) 940-6244, (499) 943-8780